開催までのスケジュール（予定）

2024年9月30日（月）	出展申込締切
2024年12月上旬	出展者説明会 ※ブースレイアウトの発表、会場構成、装飾規定、搬入・搬出などを説明します。会場・日程など詳細は10月に出展申込企業にお知らせします。
2024年12月中	展示会招待状の完成 ⇒ 配布 ※出展者には無料で希望枚数を差し上げます。
2025年1月中旬	出展ブースに関わる諸申込み締切 （電気、備品など） ※申込書類は出展者説明会にて配布。
2025年3月2日（日）～4日（火）	展示品搬入・ブース装飾
2025年3月5日（水）～7日（金）	展示会開催
2025年3月7日（金）	搬出・撤去　（17:00～21:00）
8日（土）	搬出・撤去　（9:00～17:00）
2025年5月下旬まで	終了報告書のお届け

「Grinding Technology Japan 2023」開催実績

※今回、同時開催する「Grinding Technology Japan」の2023年の開催実績

■登録来場者数

会　期	2023年	天　候
3月8日（水）	1,426名	晴れ
3月9日（木）	1,549名	晴れ
3月10日（金）	1,810名	晴れ
合　計	4,785名	ー

※リピーター（1日に複数来場した人）は1名としてカウント。
※来場者：展示会に来場した方。出展者は含みません。

■出展規模

	2023年		2021年	
出展社数／小間数	171社・団体・研究室	294小間	126社・団体・研究室	272小間
通常出展者	113社・団体	273小間	83社・団体	230小間
砥粒加工学会　研究発表コーナー	22研究室	3小間	21研究室	7小間
砥粒加工学会　卒業研究発表会	23研究室	5小間	22研究室	5小間
砥粒加工学会　賛助会員コーナー	13社	2小間	ー	ー
コンシェルジュ	／	2小間	／	2小間
実演コーナー	／	9小間	／	28小間

■出展社一覧

ISBE GmbH
/FDPW
株式会社アイゼン
/株式会社リスモツール
旭ダイヤモンド工業株式会社
Abrasivestocks.com
/磨庫網
株式会社アヤボ
株式会社アライドマテリアル
有限会社アリューズ
ANCA Machine Tools Japan株式会社
株式会社石川工具研磨製作所
株式会社イリス
/ブローム・ユング
入野機工株式会社
WINTECH AUTOMATION
株式会社宇都宮製作所
AFCジャパン株式会社
SL.CARBORUNDUM (THAILAND) CO., LTD.
NKワークス株式会社
岡崎精工株式会社
株式会社オカスギ
株式会社岡本工作機械製作所
株式会社片岡機械製作所
株式会社片桐製作所
株式会社ギケン
クール・テック株式会社
株式会社グローバルダイヤモンド
京滋興産株式会社
KFカーバイドジャパン株式会社
株式会社コイズミツール
有限会社小林超硬研磨
株式会社小宮商会

株式会社サミットスーパーアブレーシブ
三研空機株式会社
有限会社サンメンテナンス工機
/ユアサ商事株式会社
三和クリエーション株式会社
株式会社CGTech
株式会社ジェイテクト
株式会社ジェイテクトグラインディングツール
株式会社ジェイテクトマシンシステム
Shenzhen Sawa Abrasives co.ltd
ZHENGZHOU ZZDM SUPERABRASIVES CO., LTD
株式会社シギヤ精機製作所
SHANDONG TAI GUANGYI GRINDING WHEELS CO., LTD
/JAPAN TAIYU IMPORT AND EXPORT CO., LTD
XUCHANG GREAT ABRASIVE CO., LTD.
株式会社潤滑通信社
Sichuan Jiuna New Materials Co., Ltd
株式会社スギノマシン
住友重機械ファインテック株式会社
株式会社スリーエフ技研
株式会社3D Printing Corporation
セイコーインスツル株式会社
株式会社精工ドリル
切削フォーラム21
CemeCon株式会社
株式会社CERATIZIT Japan
双龍産業株式会社
大志技研株式会社
ダイナミックツール株式会社
株式会社太陽工機
ZOLLER Japan株式会社
ツクモ工学株式会社
椿本メイフラン株式会社

株式会社テイケン
株式会社東京ダイヤモンド工具製作所
株式会社東鋼
東洋研磨材工業株式会社
トランザーフィルター日本株式会社
株式会社トリオエンジニアリング
株式会社ナガセインテグレックス
ナニワトイシ株式会社
NUM AG
株式会社ニ―トレックス
日刊工業新聞社
日清工業株式会社
日本シュネーベルガー株式会社
日本ダイヤモンド株式会社
日本ウォルフラム株式会社
/CB CERATIZIT Luxembourg S.A.
日本スピードショア株式会社
/株式会社ヤマシタワークス
日本RIHON株式会社
二和ダイヤモンド株式会社
株式会社ノア
浜井産業株式会社
一般社団法人バリ取り表面仕上げ洗浄協会
バンドー化学株式会社
フォルマー・ジャパン株式会社
福田交易株式会社
二村機器株式会社
株式会社プライオリティ
ブリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社
株式会社ブンリ
HENAN HOLD DIAMOND TECHNOLOGY CO., LTD
HENAN HUIFENG DIAMOND CO.,LTD
株式会社マイスター

牧野フライス精機株式会社
松澤精工株式会社
株式会社ミスズ
三井精機工業株式会社
株式会社メトロール
株式会社ものづくりレビュー
株式会社ユーザー通信社
株式会社ユーベック
株式会社ユーロテクノ
/アガトン社
/アリコナ イメージング社
ユニパルス株式会社
株式会社リード
菱高精機株式会社
Luoyang Runbao Super Abrasive Co., Ltd.
株式会社ワークス

砥粒加工学会賛助会員展示コーナー

オオタ株式会社
株式会社岡本工作機械製作所
株式会社クリスタル光学
株式会社ジェイテクトグラインディングツール
新東工業株式会社
株式会社ティ・ディ・シー
株式会社ナガセインテグレックス
日本タングステン株式会社
日本特殊研砥株式会社
牧野フライス精機株式会社
ミクロン精密株式会社
三鷹光器株式会社
株式会社三井ハイテック

お申込・お問合せ　産経新聞社　事業本部　コンベンション事業部　「SiC,GaN加工技術展 2025」事務局
〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2　TEL. 03-3273-6180　FAX. 03-3241-4999　E-mail : sicgan@sankei.co.jp

お申込方法

※出展申込書はWEBサイトよりDLのうえ、データ上に必要事項をご入力ください(押印不要)。また大変お手数ですが、そのデータを印刷し、押印のうえPDFにしてください。必要事項入力済みデータと押印済のPDFの２つのデータを事務局(sicgan@sankei.co.jp) までメールでお送りください。

先進パワー半導体ウエハ加工技術に関する専門展示会

出展のご案内

SiC, GaN 加工技術展2025

SiC, GaN Machining Technology Exhibition 2025

2025.3.5（水）▸ 3.7（金）10:00-17:00　幕張メッセ

主催／日本工業出版　産経新聞社

www.sicgan-expo.jp

ご挨拶

研削加工の専門技術展「Grinding Technology Japan 2025」と同時開催において、「SiC,GaN加工技術展2025」を開催します。
2050年のカーボンニュートラル社会の実現にはモビリティーの電動化（EV）の推進や再生可能エネルギーの主力電源化が不可欠であり、SiC,GaNなどの先進パワー半導体を用いた高度なパワーエレクトロニクス技術の普及が最重要となってきています。
そのため、先進パワー半導体ウエハの量産化・低コスト化が強く望まれていますが、これらの材料は非常に硬く、熱や薬品にも強いため、加工には非常に時間がかかっており、高額な加工コストの低減が喫緊の課題となっています。
「SiC,GaN加工技術展」は、これらの先進パワー半導体ウエハ加工に携わる技術者、技能者、また先進パワー半導体の研究者、さらにそれらを学ぼうとする人たちのための展示会です。出展者は、それら課題を持った来場者に対し、最新の技術・知識で最良の回答を用意できると考えております。「SiC,GaN加工技術展」には、先進パワー半導体ウエハ加工に関連するスライシング（切断）、研削・研磨・CMP加工技術を中心に、ウエハ評価技術などさまざまな技術も多数展示されます。
「SiC,GaN加工技術展」には、砥粒加工分野を主な研究対象として活動している公益財団法人砥粒加工学会及び、SiC,GaN、ダイヤモンドなど先進パワー半導体を研究対象としている公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会が“特別協力”団体として参加します。
先進パワー半導体ウエハ加工を進展させるためには、技術・技能に加えて、理論的な裏付けが重要であることに議論の余地はありません。「SiC,GaN加工技術展」において砥粒加工学会等の協力団体では、アカデミックな立場から、加工の理論解説をするとともに、半導体ウエハ加工技術の将来についても展望します。

開催概要

名　称　SiC,GaN加工技術展 2025

主　催　日本工業出版（株）
（株）産経新聞社

会　期　2025年3月5日（水）～7日（金）　10:00 ～17:00

会　場　幕張メッセ　7-8ホール　〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1　Tel. 043-296-0001　https://www.m-messe.co.jp

特別協力　公益社団法人砥粒加工学会、公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会

協　賛　日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機器工業会、日本フルードパワー工業会、日本歯車工業会、日本機械鋸・刃物工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、SiC アライアンス、GaNコンソーシアム

出展対象　SiC,GaN用インゴットスライシング装置、SiC,GaN用ウエハ研削装置、SiC,GaN用研削砥石、ウエハ端面研削・研磨装置、SiC,GaN用片面・両面ラッピング装置、SiC,GaN用CMP装置、SiC,GaNウエハ専用研磨材スラリー、ウエハ洗浄システム、ウエハ形状測定機

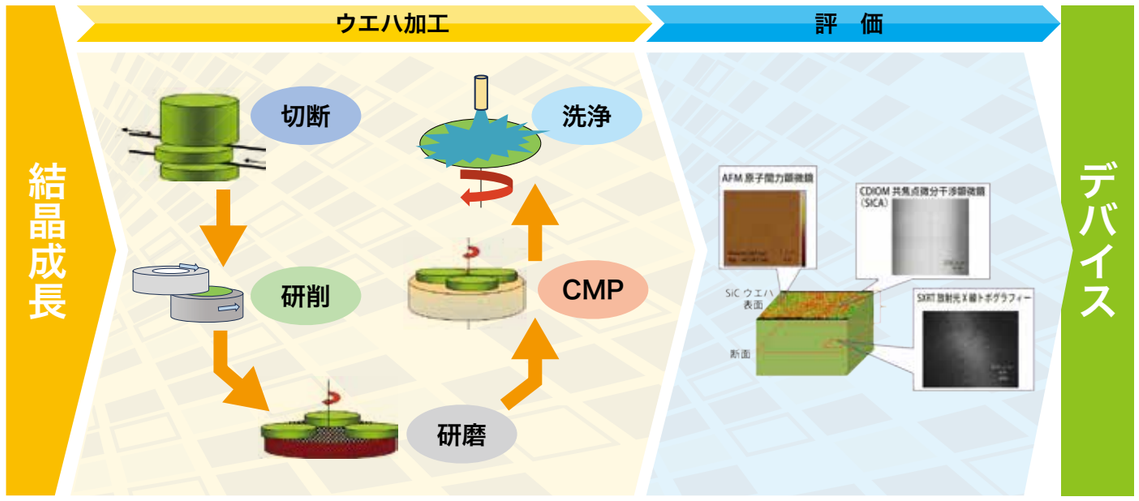
来場対象　SiC,GaN単結晶成長技術者・研究者、SiC,GaNウエハ加工技術者・研究者、ダイヤモンドウエハ技術者・研究者、ウエハ評価技術者・研究者、学生、他

同時開催　「Grinding Technology Japan 2025」

出展対象　研削盤、研磨盤、砥石、ツルーイング装置、計測機器、周辺機器、研削工具、工具研削盤、切削工具、切削工具製造技術、切削工具活用技術、切削油、切削油供給装置、切削油ろ過装置、他

来場対象　研削加工技術者・研究者、工具製造者、研削加工業者、学生、他

SiC,GaN 加工技術展　展開イメージ



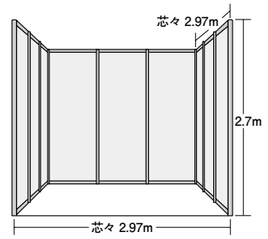
出展要項

申込締め切り　**2024年9月30日（月）**

Aタイプ

出展小間規格

1小間＝9㎡（間口3m×奥行3m×高さ2.7m）　側壁・後壁のみ設置（角小間は側壁なし）



出展料

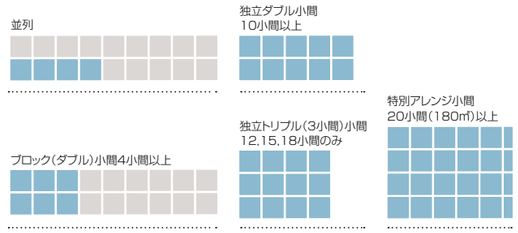
1小間 **418,000円**（税込）

一般の10小間を超える申込の場合、下記の割合で出展料を割引します。
10～19小間　　出展料金の5%
20小間以上　　出展料金の10%

小間形態・装飾高さ制限

1～3小間　… 並列小間のみ
（高さ：4mまで使用可能※但し、1mセットバックした部分のみ）
4～9小間　… 並列小間、ブロック小間より選択可能
（高さ：4mまで使用可能　※但し、並列小間は1mセットバック）
10小間以上　… 原則独立小間のみ（高さ：5mまで使用可能）
※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談下さい。

小間のレイアウト　展示物やブースの設営方法にあわせて、並列・ブロック・独立ダブル・独立トリプル・特別アレンジの5通りの小間アレンジが可能です。



出展料に含まれる費用

基準時間内の会場使用料金・照明・空調費、共有施設の工事費及び維持費、来場者プロモーション費、来場者サービスにかかわる費用（会場案内等の制作）、会場事務局運営・安全管理・警備費用

出展料に含まれない費用

出展者の小間装飾費・搬出入費及び運営費用、電気・ガス・水道等の設備一時幹線工事及び二次側工事と使用料（システムパッケージ申込は別途）、臨時電話等通信回線の架設費用と通信料金、出展機器及び対人傷害などの保険料、会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費、放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係る費用、その他、通常出展料に含まない費用とみなされるもの

パッケージ装飾

※詳細・申込については、出展者説明会にてご案内いたします。
※料金は変更になる可能性があります。
※出展料とは別に発生いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

小間装飾パッケージプラン

● パラペット　● 受付カウンター　● 折りたたみ椅子（1ケ）　● 照明（蛍光灯20W×1+スポットライト15W×2）　● コンセント（2口）一ヶ所（100V-900Wまで使用可能）
● 社名表示　● カーペット　● 名刺受（1ケ）　● 1kW以内の電気幹線工事、使用料含む　● カタログスタンド（A4/12段）（1台）

158,400円（税込）

Bタイプ　1社1小間限定

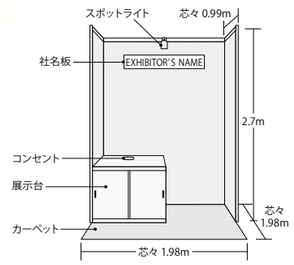
出展小間規格

1小間＝間口2.0m× 奥行2.0m× 高さ2.7m　一定装飾付き（角小間は側壁なし）

出展料 ※出展料、簡易装飾込み

242,000円（税込）

出展料に含まれるもの：間口2.0m× 奥行2.0mの展示スペース、間仕切り（後壁、側壁1m）、社名板、カーペット、展示台：横幅1.0m× 奥行1.0m× 高さ0.8m、引き戸ユニット（鍵ナシ）、スポットライト：22W×1、コンセント（アース付100V）：2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料
※備品の追加注文がある場合は、別途ご請求させていただきます。詳しい資料は出展社説明会にてお渡しいたします。
※上記基本ディスプレイを使用しない場合も、料金を差引くことはできませんのでご了承ください。



製品・技術発表会

展示会場内の特設セミナースペースで開催する新技術・新製品PRセミナー

日　　時：2025年3月5日（水）～7日（金）10:00～17:00 内で45分間
場　　所：展示会場内特設会場（シアター形式 80名定員）
発表料金：1セッション 55,000円（税込）
運営方法：1、聴講無料（各回総入替）
2、受付・進行は発表各社が担当（登録や名刺回収は自由です）
会場設備：受付（机、イス）、聴講席、演台、マイクセット、プロジェクター、スクリーン
P　　R：案内状、ホームページ等に社名・プログラムを掲載

〈注〉・申込書に20字以内でセミナータイトルを記載下さい。
・終了後は現状復帰をお願いいたします。
・PC使用の場合は各自お持込下さい。※接続テスト等はご相談下さい
・発表日時は主催者にて決定します。

公式Webサイト バナー広告

貴社のリンクバナーを公式WEB（和・英）に開催1か月前から掲載

掲載期間：2025年2月5日（水）～4月7日（月）　※予定
画像サイズ：W200px × H40px　GIF形式　※アニメーションGIF可
掲載料金：1枠 55,000円（税込）
原稿締切日：2025年1月17日（金）※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。